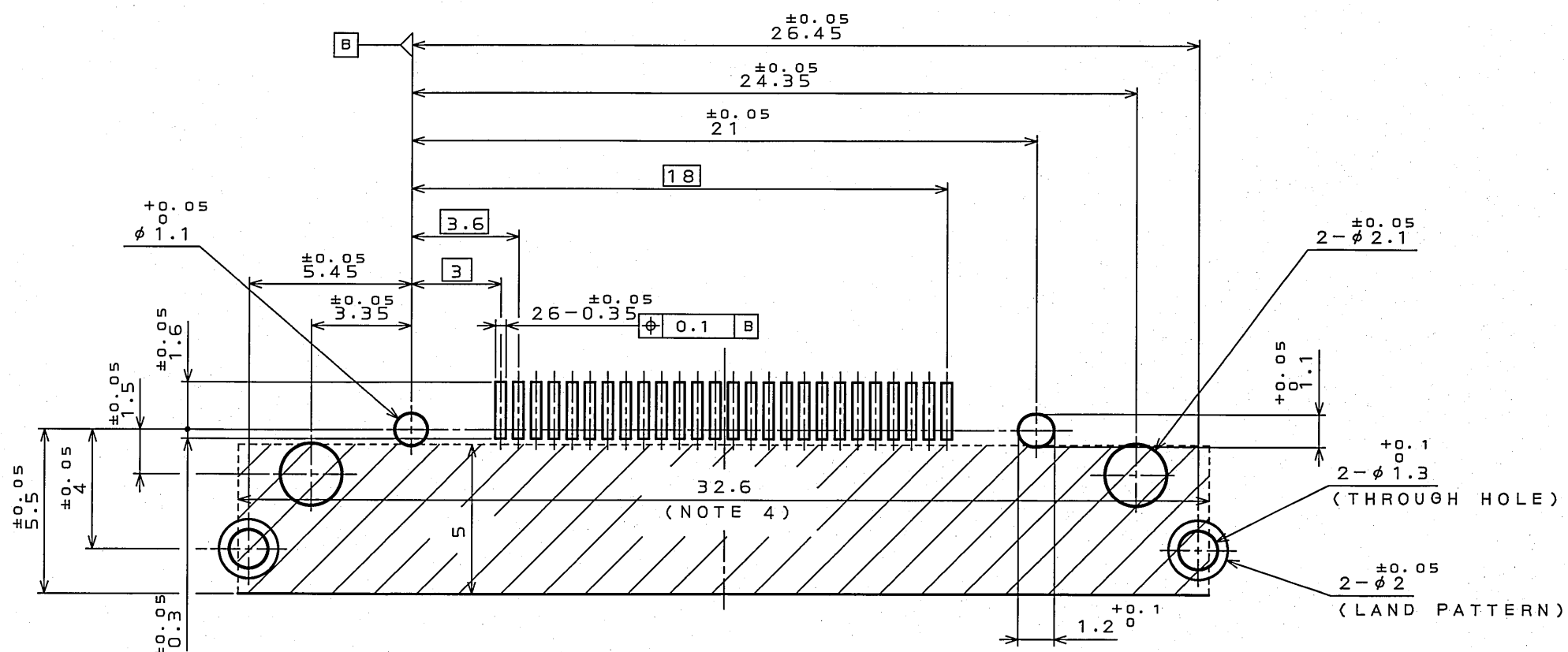
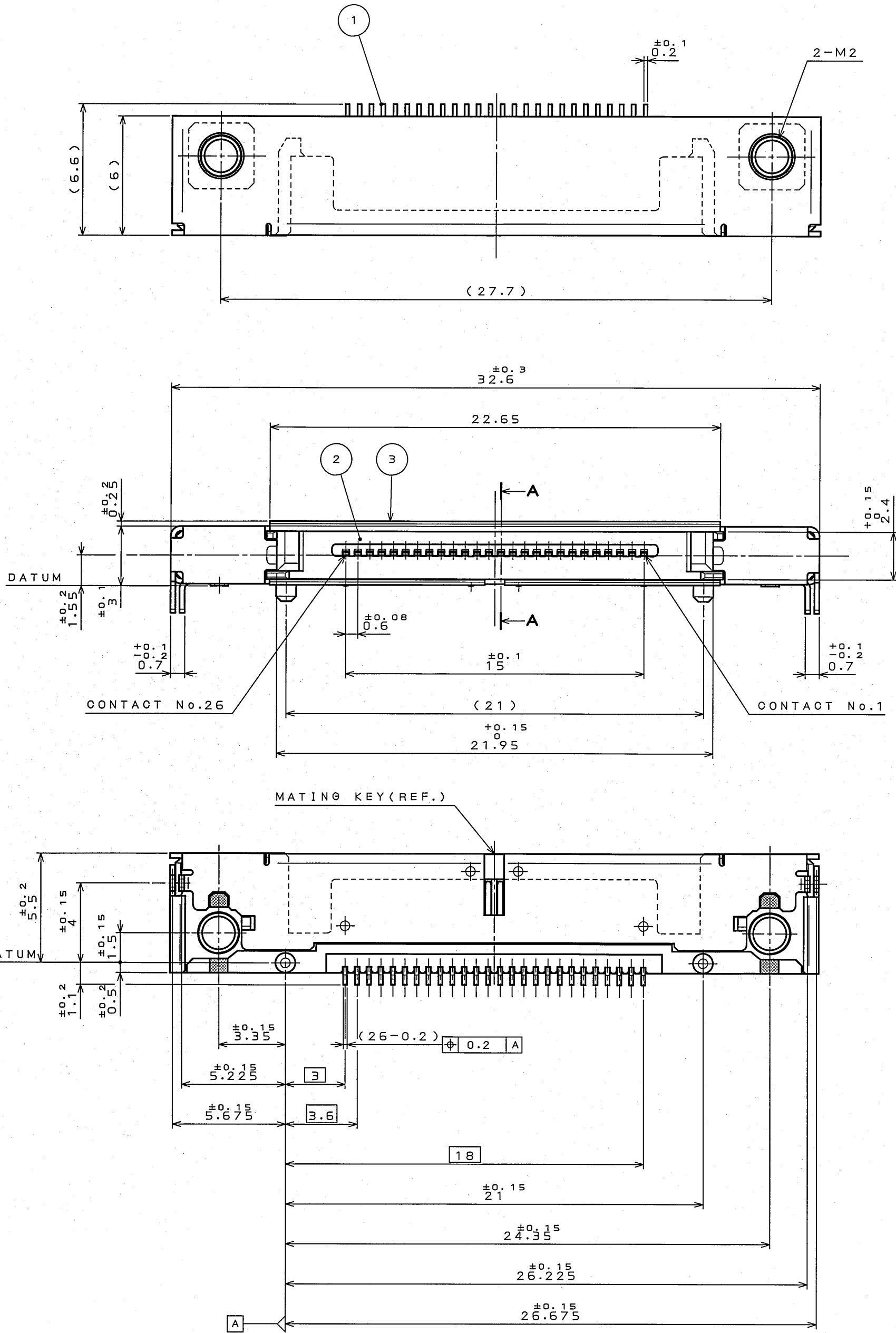
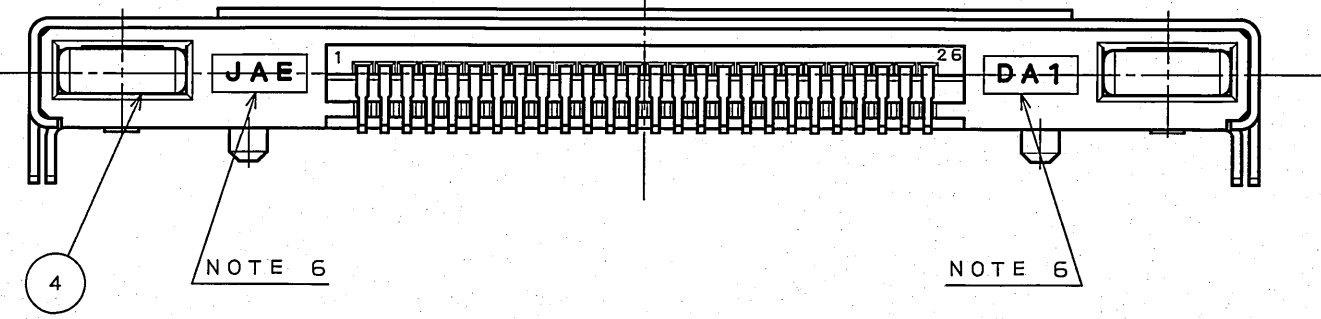
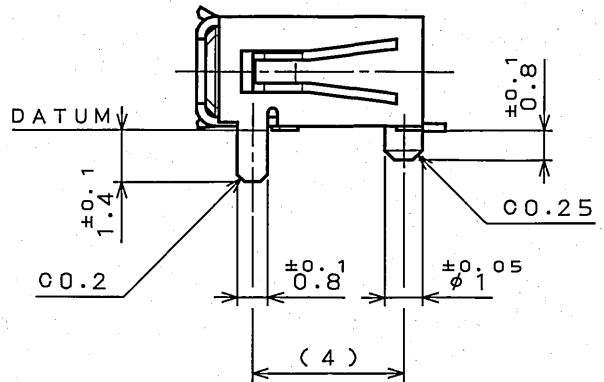


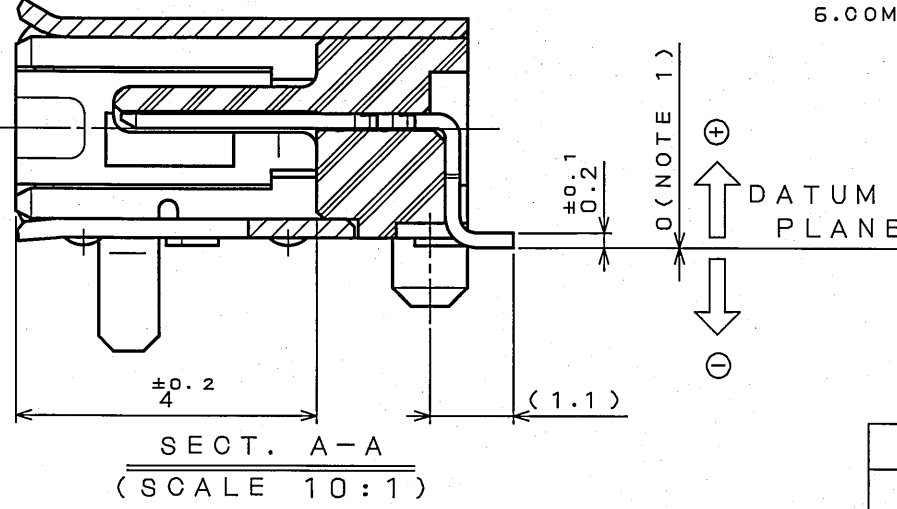
版数 REV.	年月日 DATE	DON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	16.Dec.2004	056414	FINISH CHANGE、OTHERS		Y.TAKAGI		



APPLICABLE P.O.B DIMENSION(REF.)(SCALE 5:1)



- NOTE1.◎ AND ⊙ DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERANCE.TERMINAL DIMENSION IS $0^{+0.05}_{-0.1}$, AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
- △2.THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH(0.03μmMIN) OVER Pd-NI(0.4μmMIN) OVER NICKEL(1.5μmMIN). THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH(0.03μmMIN) OVER NICKEL(1.5μmMIN).
- 3.THE SHEARED EDGES OF CONNECTOR SHELL AT THE SOLDER AREA ARE NOT PLATING.
- 4.PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
- 5.LAND MARK BOTH SIDES OF P.O.B. HOLE OF $\phi 1.1$ IS THROUGH HOLE PLATED.
- 6.COMPANY LOGO "JAE" AND PART NUMBER "DA1" ARE MARKED AS INDICATED.



- 注1.SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は $0^{+0.05}_{-0.1}$ であり公差内におけるバラツキ(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差)は、0.1以下とする。
- △2.接触部は、ニッケル(1.5μm以上)上パラジウムニッケル(0.4μm以上)上金フラッシュメッキ(0.03μm以上)結線部は、ニッケル(1.5μm以上)上金フラッシュメッキ(0.03μm以上)である。
- 3.本コネクタシェル半田付部破断面には、メッキは施されません。
- 4.本材料線部内にはパターンを配線しないよう願います。
- 5.ランドは基板の両面に設けること。又、 $\phi 1.3$ の穴はスルーホールメッキであること。
- 6.図示の位置に社標 "JAE" 及び品名 "DA1" を表示する。

4	NUT	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	PPS		UL94 V-0
1	CONTACT	26	COPPER ALLOY	NOTE 2	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003	尺 寸 SIZE(SERIES)	5:1	DA1
製図 DR.	E.MURANO	名称(TITLE)	DA1R026L91E		
担当 CHK.	Y.TAKAGI	製図 APPD.	Y.KUBOTA		
承認 APPD.	Y.KUBOTA	質量(MASS)			
図面番号(DRAWING NO.)					版数 (REV.)
SJ038459					2